

ウシオ電機株式会社 2024 年 個人投資家さま向け説明会

主な質問と回答

開催日 : 2024 年 12 月 20 日

運営 : 大和インベスター・リレーションズ

説明者 : 代表取締役社長 CEO 朝日 崇文

Q1 : 半導体関連事業の具体的な内容と売り上げ割合を教えてください。

A1 : 半導体の前工程・後工程の両方でウシオの光を提供しています。全体の連結売上高の中で 30%強が半導体関連の売り上げです。前工程ではウシオの光源や光源ユニット、後工程では露光装置およびそれに関わる光源を製品としてラインアップしています。

Q2 : 競合会社はどちらになりますか。

A2 : 各事業により競合は異なります。ランプで言うとドイツの OSRAM が最大の競合です。ステッパ露光装置では米国の Onto Innovation です。直描式のダイレクトイメージング露光装置では、日本ではオーク製作所や SCREEN ホールディングスが挙げられます。映像装置事業のシネマ向けで言うとベルギーの Barco が最大の競合です。一般映像向けハイエンド領域では Barco の他にもパナソニックやエプソンが挙げられます。

Q3 : 今期の業績は厳しいようですが、来期以降はどうなりますか。

A3 : 半導体市場は生成 AI 領域を除き、世界的に良好ではなく、当社も影響を受けています。映像事業領域でも、2023 年にハリウッドでストライキがあり、本年は大作となるような良いコンテンツが少なく、映画館の稼働も低い状況です。一方で、特に半導体等のインダストリアルプロセス事業向けで将来に向けての先行投資を積極的に行っています。以上のような背景で、本年度の業績は一時的に低迷する見込みとなっています。しかしながら、半導体の特に後工程、アドバンスドパッケージ市場は、世界的に拡大していくことがほぼ約束されています。中長期先を見据え、当社もそれらに対して先行投資を多く行っている状況であり、今後の大きな成長を目指しています。

Q4 : 活況な生成 AI 半導体分野ではどのように関わっていますか。

A4 : 後工程に関わっています。生成 AI 向けのチップは高密度・高精細なパッケージ基板や、インターポーザーなど、何層にも重なる基板が必要になります。そのパッケージに使う基板に対して、当社の露光装置の高い技術が貢献できます。特に、アプライド・マテリアルズ社との協業によるデジタルリソグラフィ装置では、極めて配線の細いインターポーザー基板等に貢献可能です。その他にも前工程で従来型のランプが貢献しています。

Q5 : トランプ政権発足により関税や半導体規制などではどのような影響が想定されますか。

A5 : 現時点では大きな影響はそれほどないのではと想定していますが、一部で、中国で生産し米国へ輸出しているプロジェクター等の商品があります。大きな関税がかかると、その分の影響が出てきます。米国内はそれほど多くの競合がない状況ではあるため、関税があっても当社製品の需要への影響は小さいかもしれません。そうはいつでも、関税によって

価格は上がるため、マーケット的には少し冷え込む影響があるかもしれません。また、米中の摩擦が大きくなり、中国経済が影響を受けると、半導体領域を中心とするインダストリアルプロセス事業等への影響も出てくる可能性はあるかもしれないと考えています。

以上